

2025年度
決算説明会資料

2026年5月21日



株式会社 メイコー

(証券コード：6787)

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

1

2025年度実績および、
2026年度予想

2

中期経営計画

3

新工場の様況

2025年度実績と2026年度予想

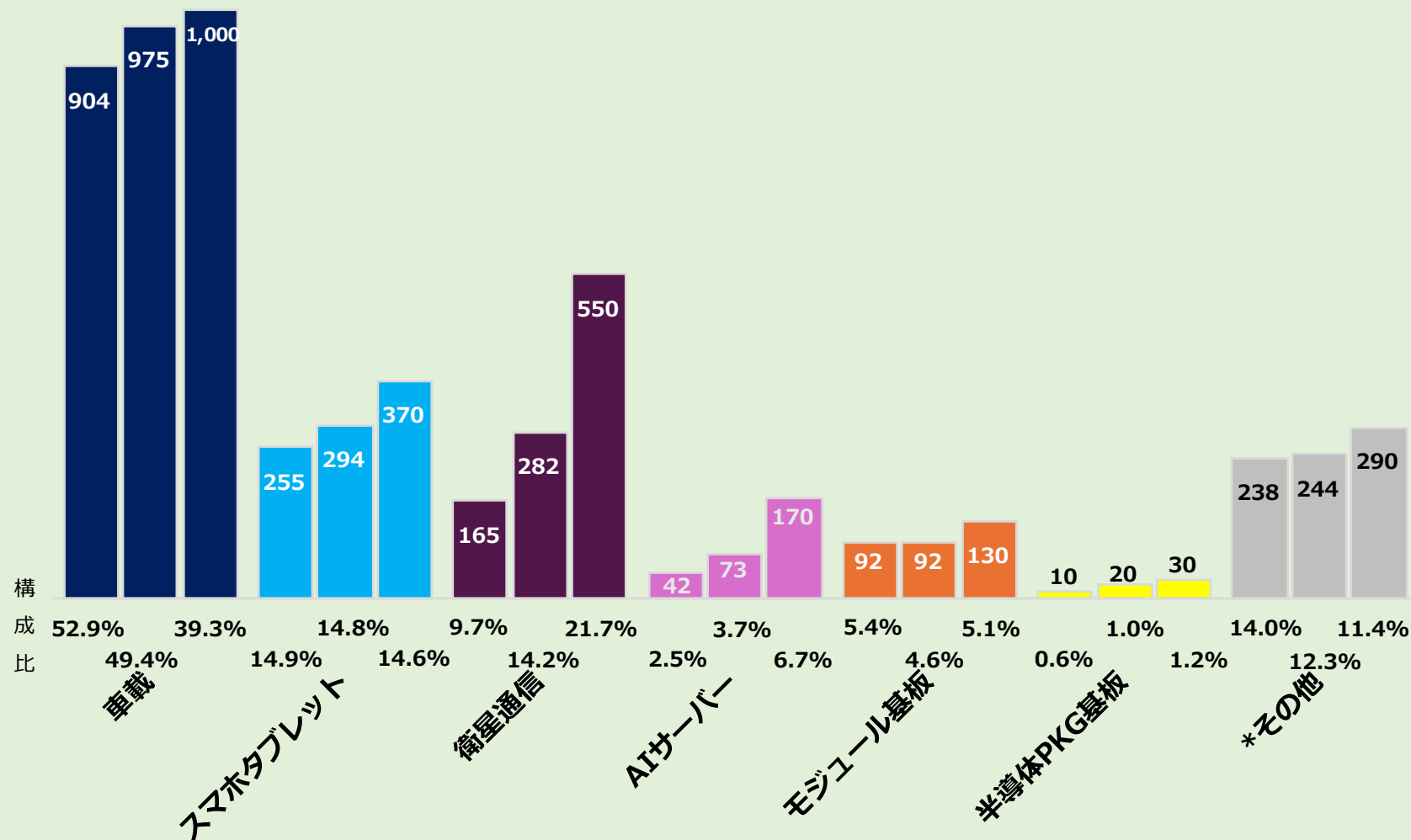
(単位：億円)

		2024年度		2025年度		2026年度	
		通期実績	利益率	通期実績	利益率	通期予想	利益率
売上高	回路基板	1,706		1,980		2,540	
	電子機器	362		426		660	
		2,068		2,406		3,200	
営業利益	回路基板	172	10.1%	212	10.7%	334	13.1%
	電子機器	19	5.2%	34	8.0%	46	7.0%
		191	9.2%	246	10.2%	380	11.9%
経常利益		188	9.1%	265	11.0%	350	10.9%
当期純利益		149	7.2%	198	8.2%	270	8.4%
期中平均為替レート (JPY/USD)		152.57		151.06		150	

商品別売上高 2024~2026年度

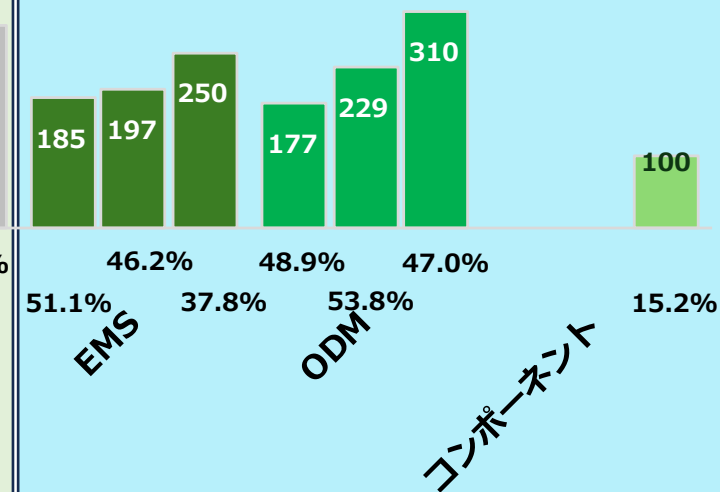
(単位：億円)

回路基板



*その他は、アミューズメント、スマート家電、産業機器、その他基板

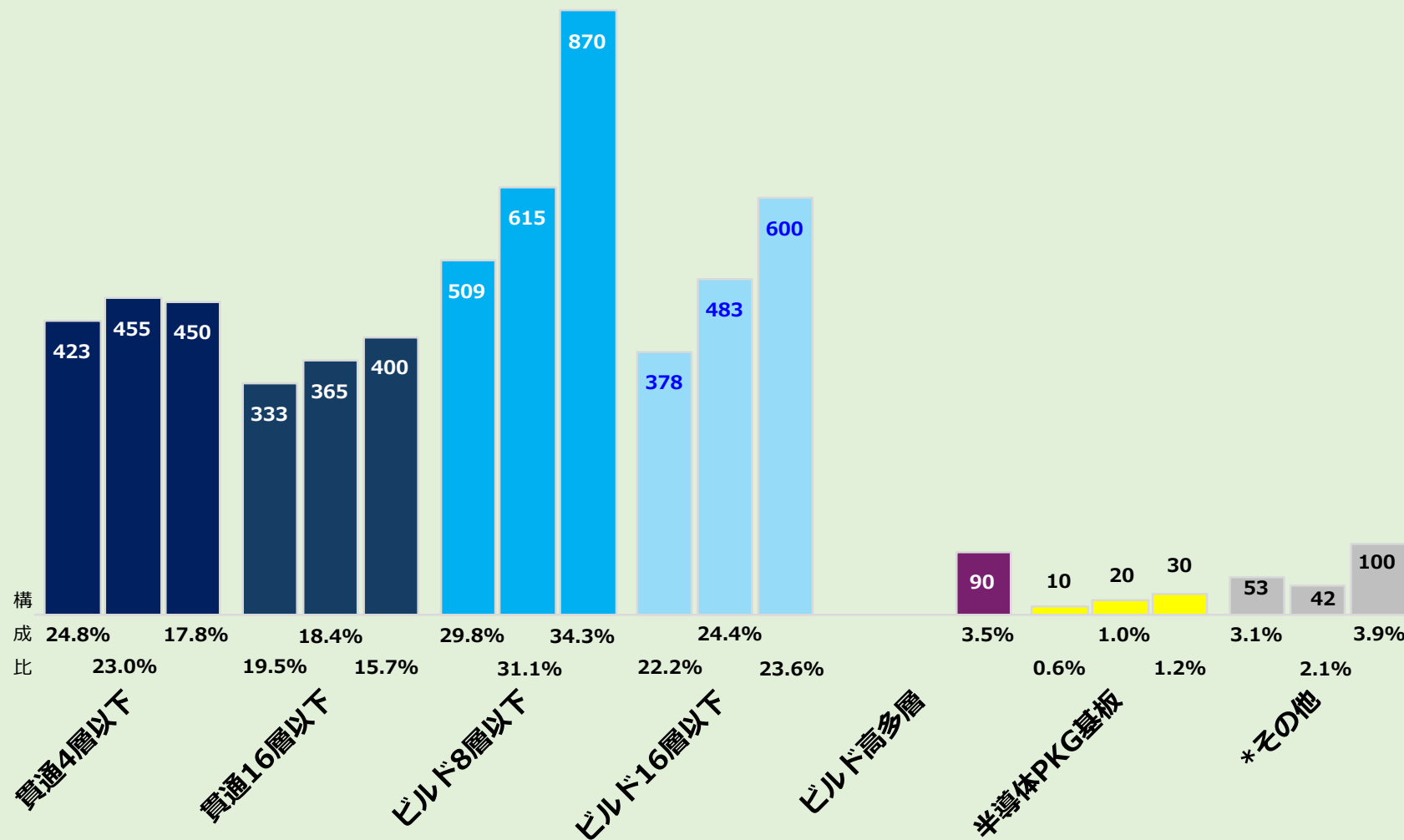
電子機器



製品別売上高 2024~2026年度

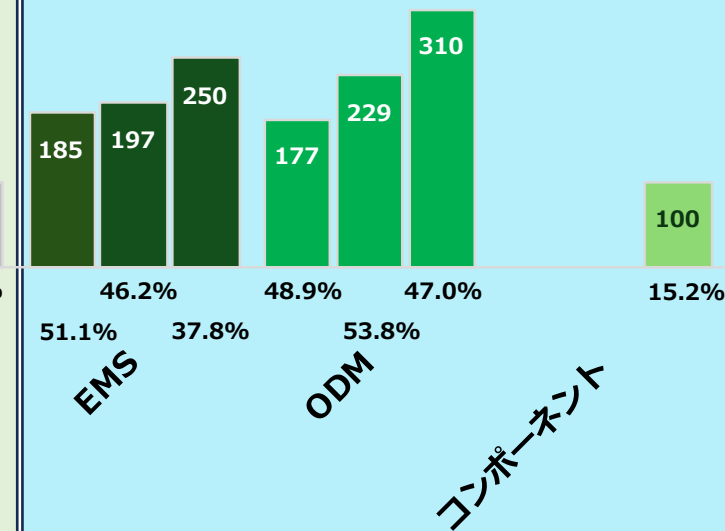
(単位：億円)

回路基板



*その他は、リジッドフレキ、フレキ、放熱、大電流、その他基板

電子機器



1

2025年度実績および、
2026年度予想

2

中期経営計画

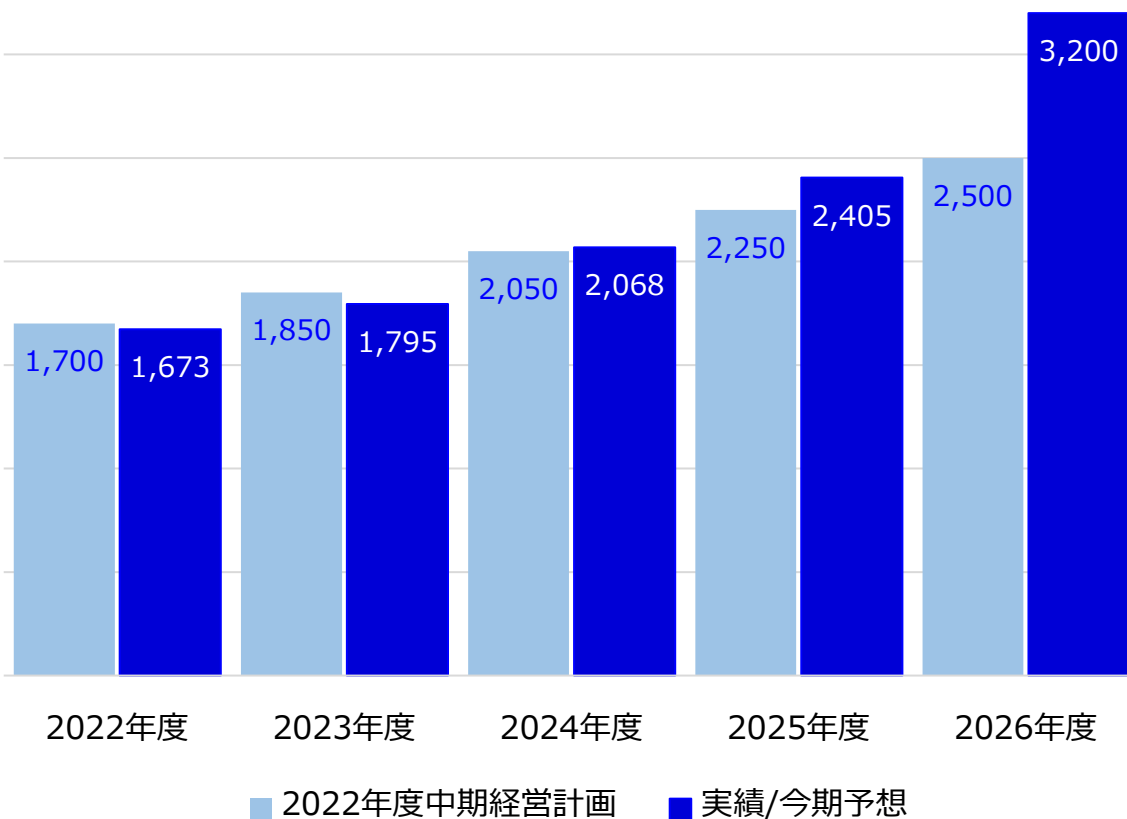
3

新工場の様況

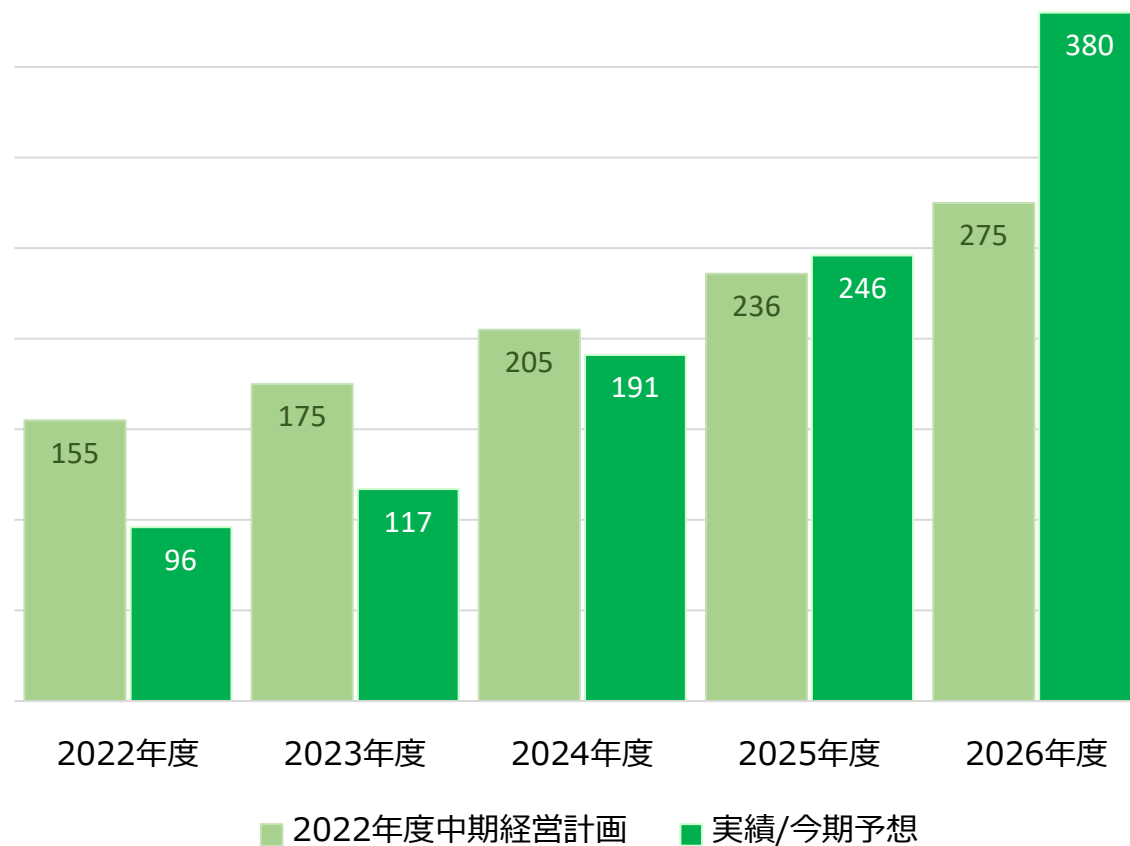
2022年度作成中期経営計画の振り返り

(単位：億円)

売上対比



営業利益対比

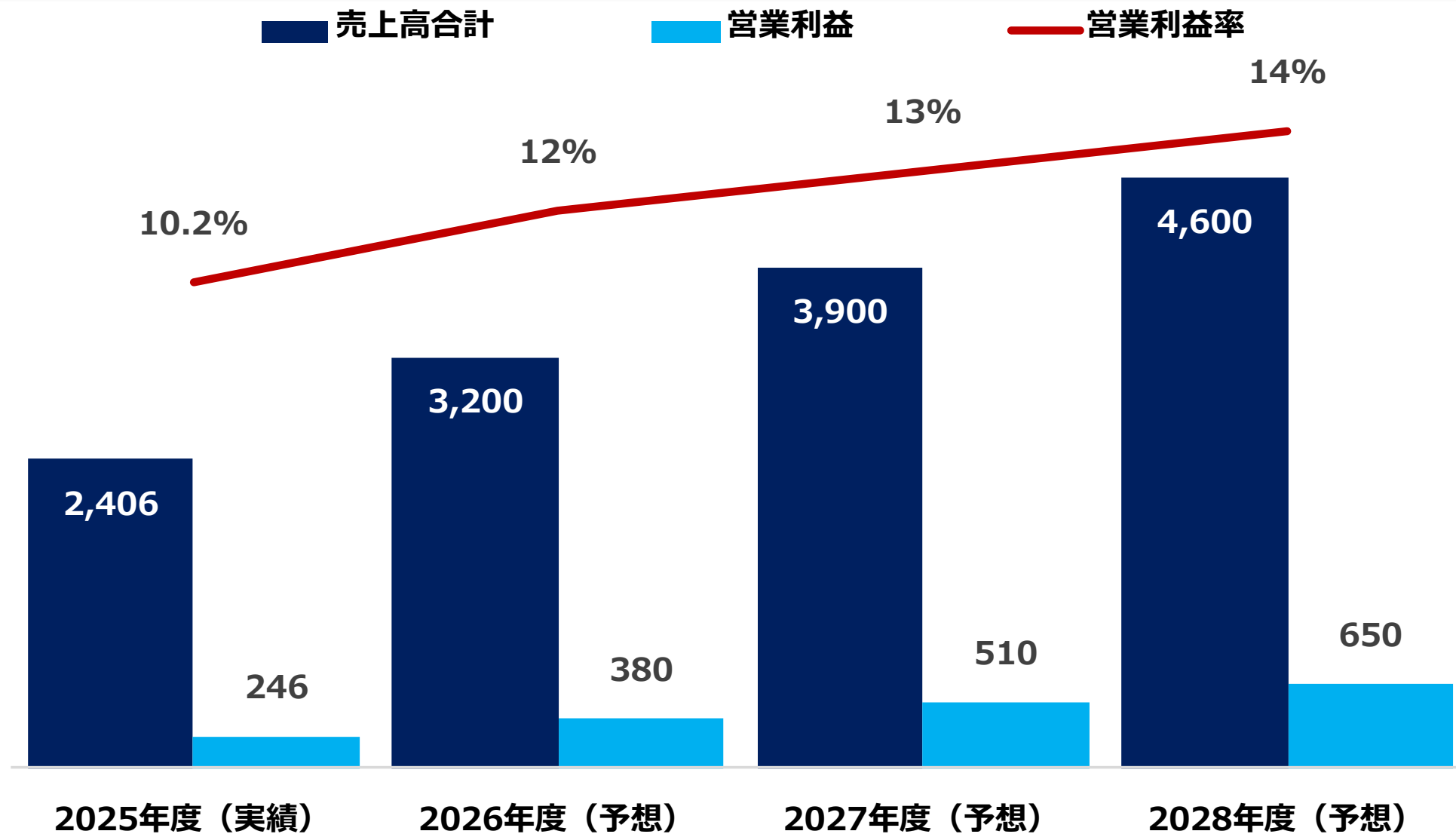


設備投資額

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	投資累計
中期経営計画	200	200	200	200	200	1,000
実績/予想	174	199	298	497	700	1,900

中期経営計画 概要

(単位：億円)



設備投資額

497

700

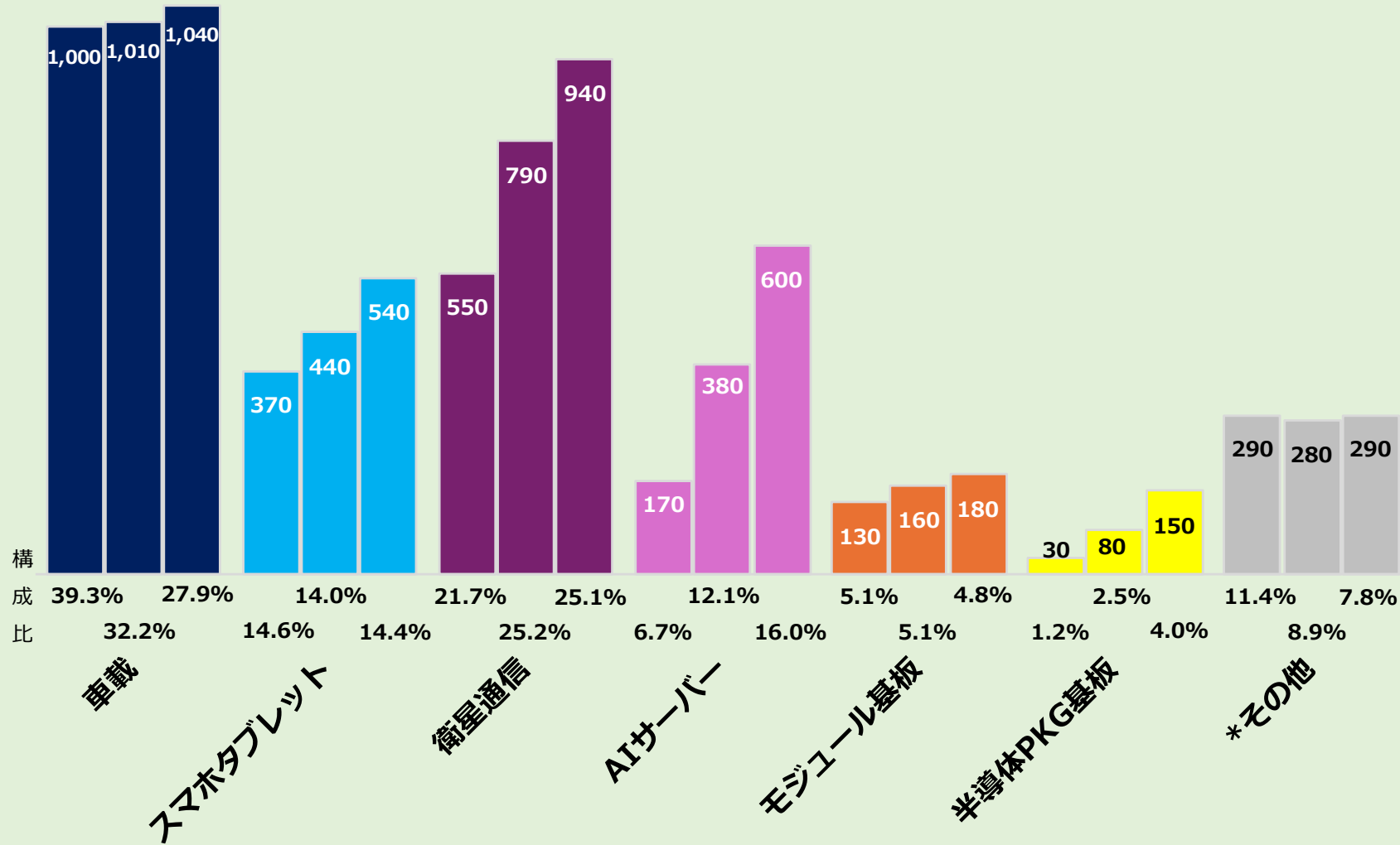
700

700

中期経営計画 商品別売上高（2026～2028年度）

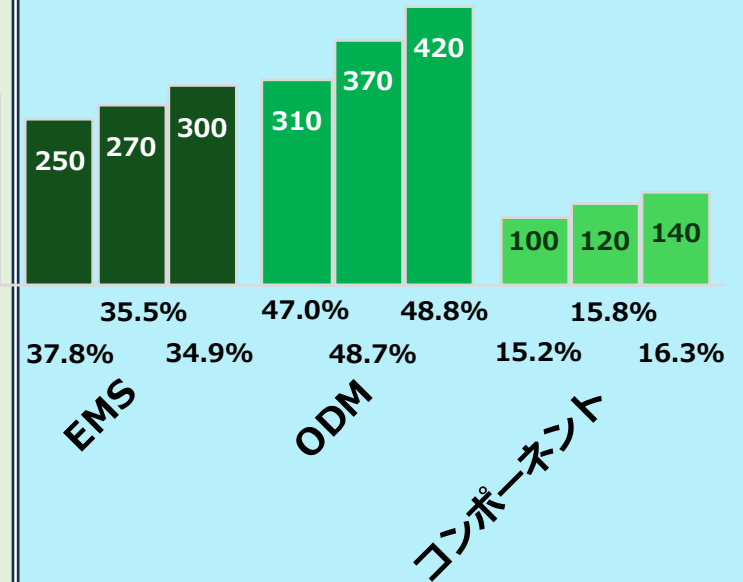
（単位：億円）

回路基板



*その他は、アミューズメント、スマート家電、産業機器、その他基板

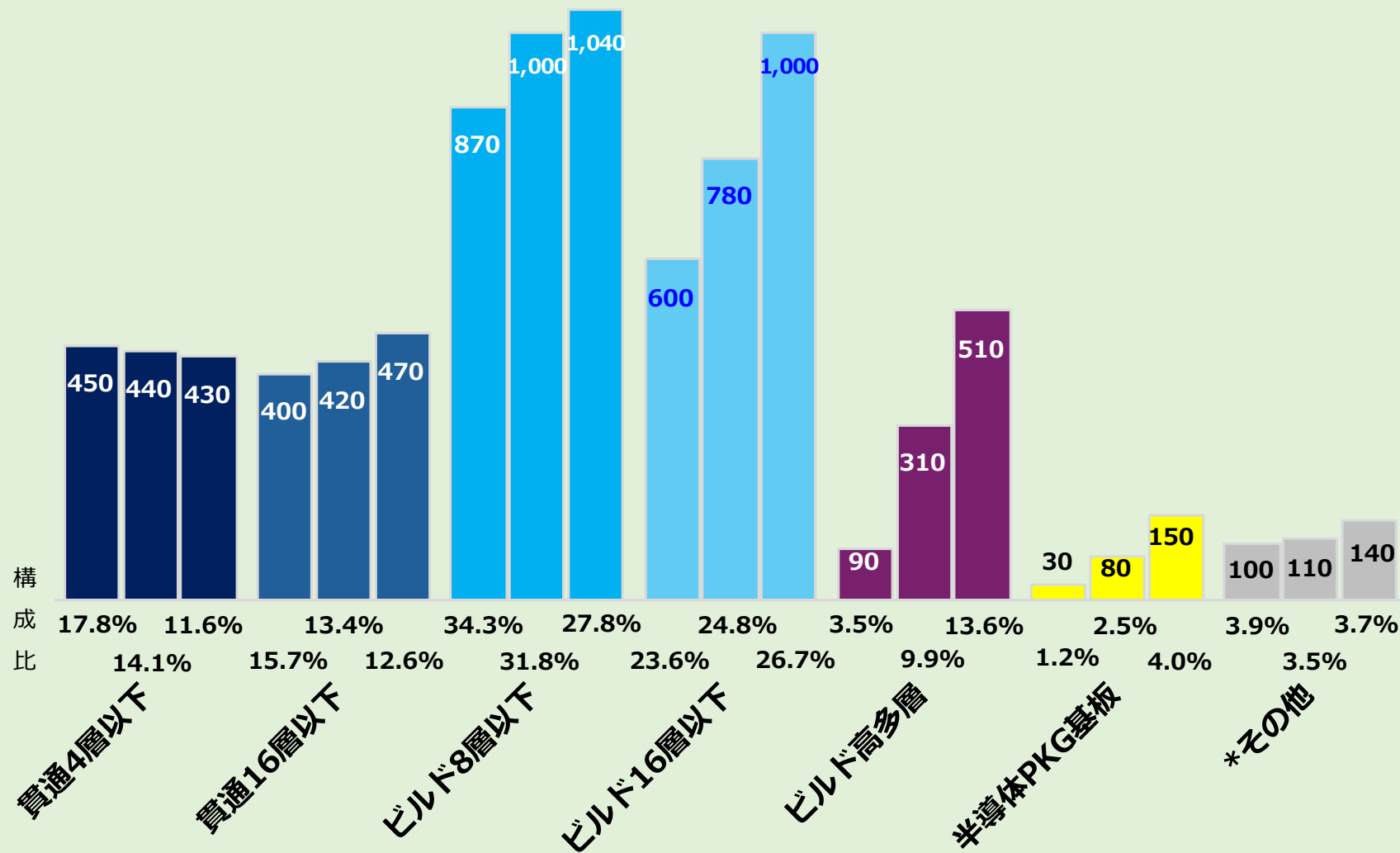
電子機器



中期経営計画 製品別売上高 (2026~2028年度)

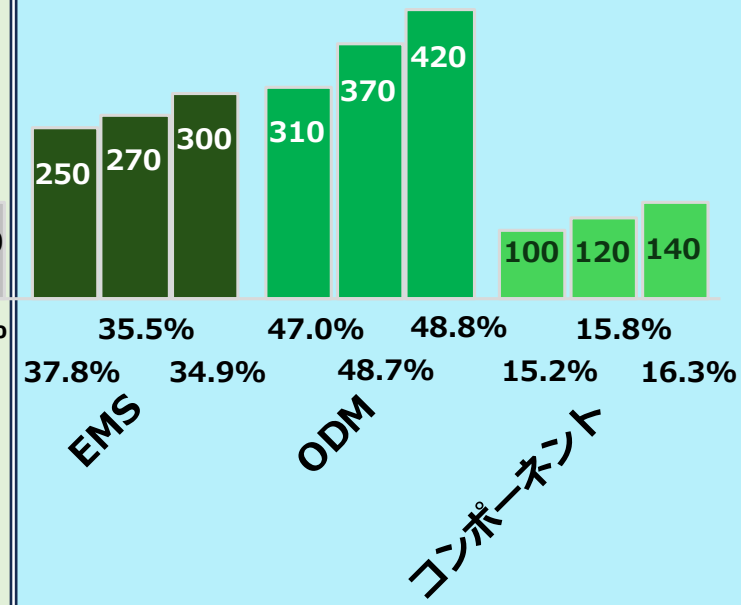
(単位：億円)

回路基板



*その他は、リジッドフレキ、フレキ、放熱、大電流、その他基板

電子機器



財務指標と株主還元予想

為替レート：150円(JPY/USD)

(単位：億円)

	2025年度 (実績)	2026年度 (予想)	2027年度 (予想)	2028年度 (予想)	2025-2028 年平均成長率
売上高合計	2,406	3,200	3,900	4,600	24.1%
営業利益	246	380	510	650	38.2%
営業利益率 (%)	10.2	12	13	14	
経常利益	265	360	485	625	33.1%
当期純利益	198	270	365	470	33.4%
投資額	497	700	700	700	
研究開発費	60	80	100	115	
EBITDA	368	554	858	1,070	
総資産合計	3,353	4,175	4,818	5,453	
純資産合計	1,438	1,663	1,820	2,219	
有利子負債残高	1,219	1,785	2,114	2,193	
自己資本比率 (%)	40.7	38.2	36.3	39.4	
D/Eレシオ	0.85	1.07	1.16	0.99	
ROE (%)	14.6	17.1	20.1	21.1	
ROIC (%)	7.7	9.6	10.5	11.8	
1株当たり純利益 (円)	744	1,040	1,362	1,749	
1株当たり配当額 (円)	115	160	200	260	
総配当額 (億円)	31	43	54	70	
配当性向 (%)	15	15	15	15	
DOE (%)	2.1	2.6	2.9	3.1	

1

2025年度実績および、
2026年度予想

2

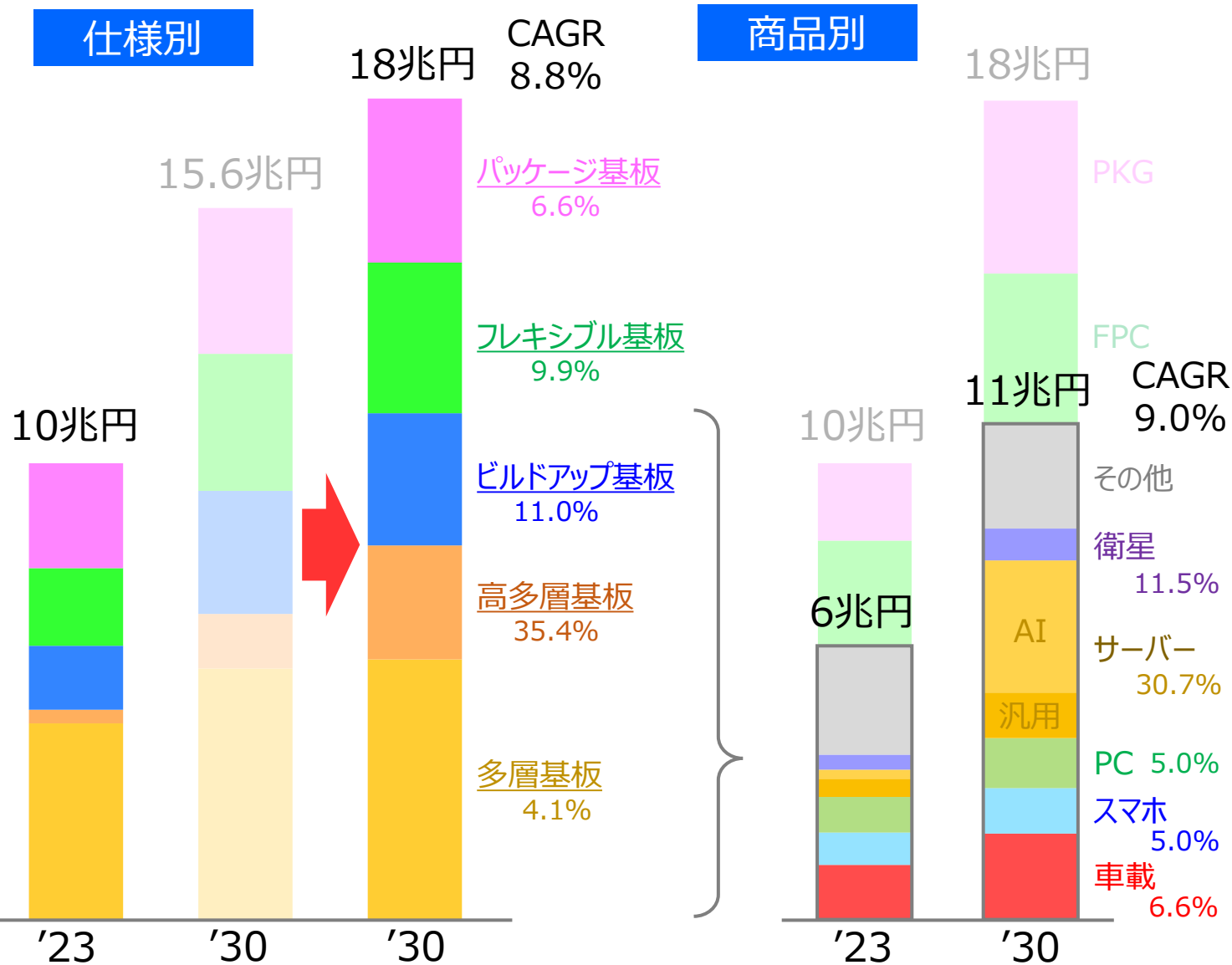
中期経営計画

3

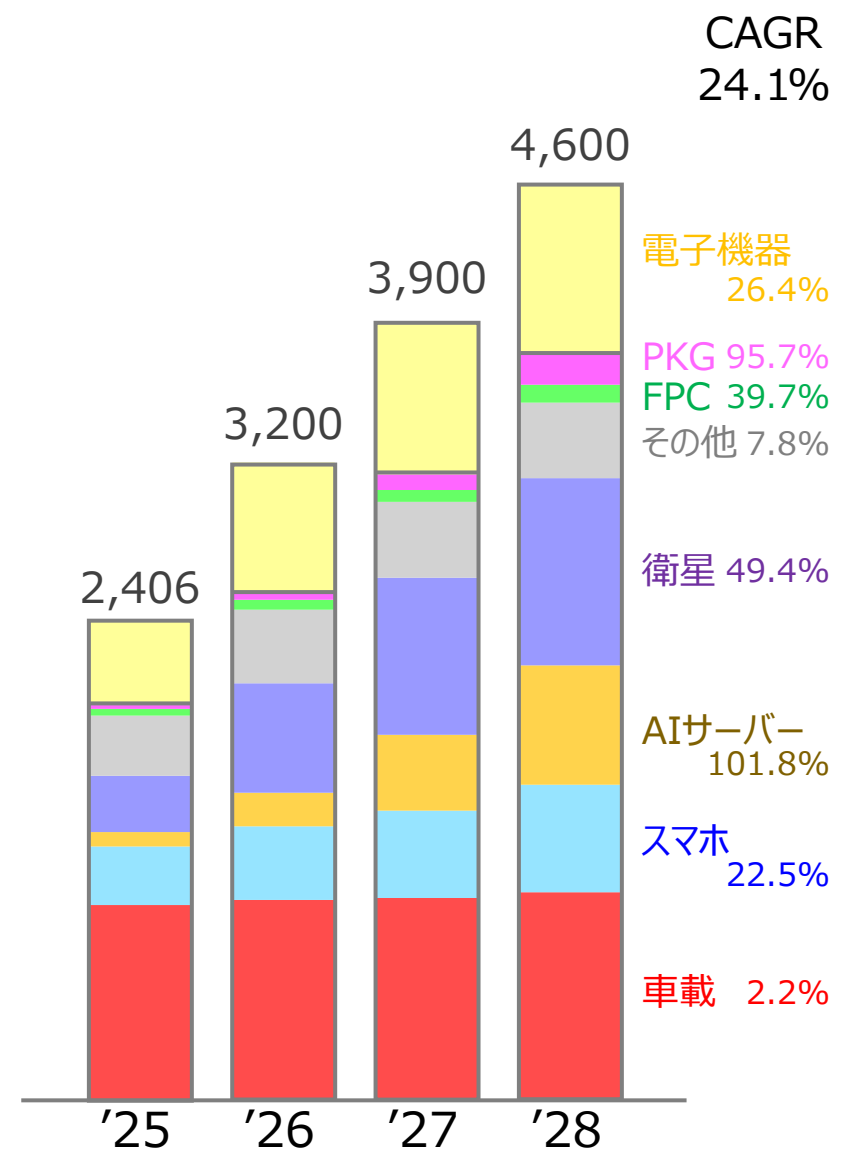
新工場の状況

プリント基板市場の最新予測と当社中期3カ年計画

【プリント基板世界市場】



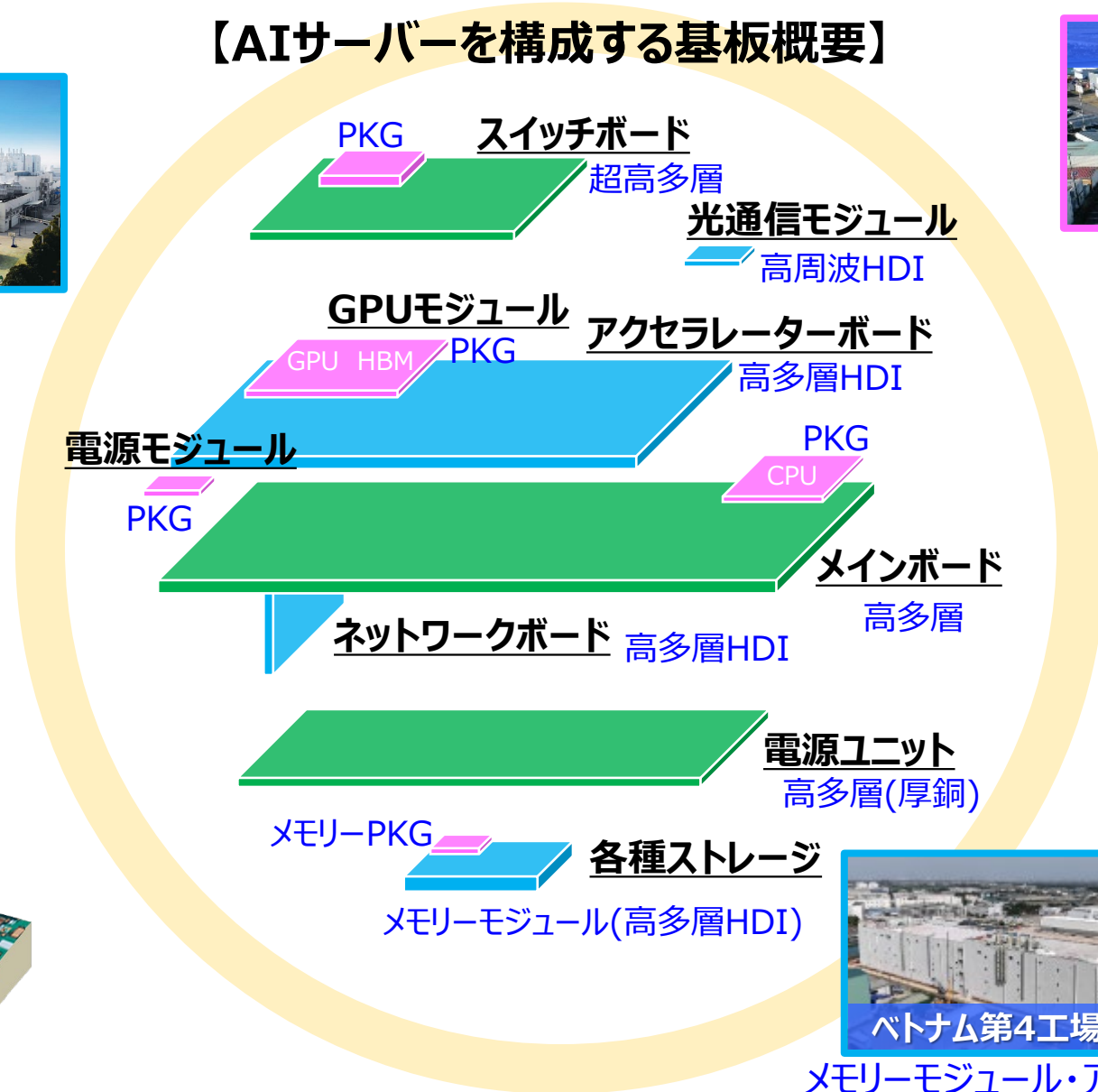
【当社中期3カ年計画】 (億円)



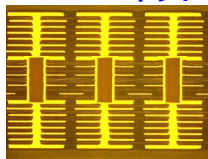
※外部調査会社データに基づき当社が予測

AIサーバーを構成する各種基板向け生産戦略

【AIサーバーを構成する基板概要】



ネットワークボード・
メモリーモジュール

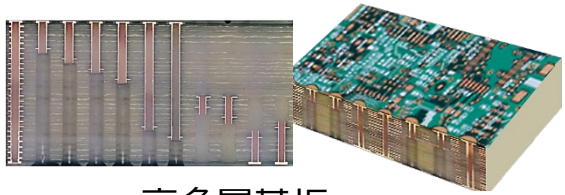


メモリーモジュール基板



ホアビン第2工場

メインボード(J/V)

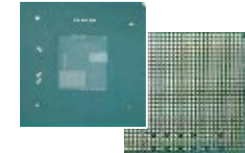


高多層基板



石巻工場

ロジック系PKG基板



FC-BGA基板



ベトナム第3工場

メモリー系PKG基板

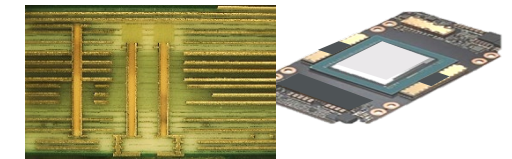


CSP基板



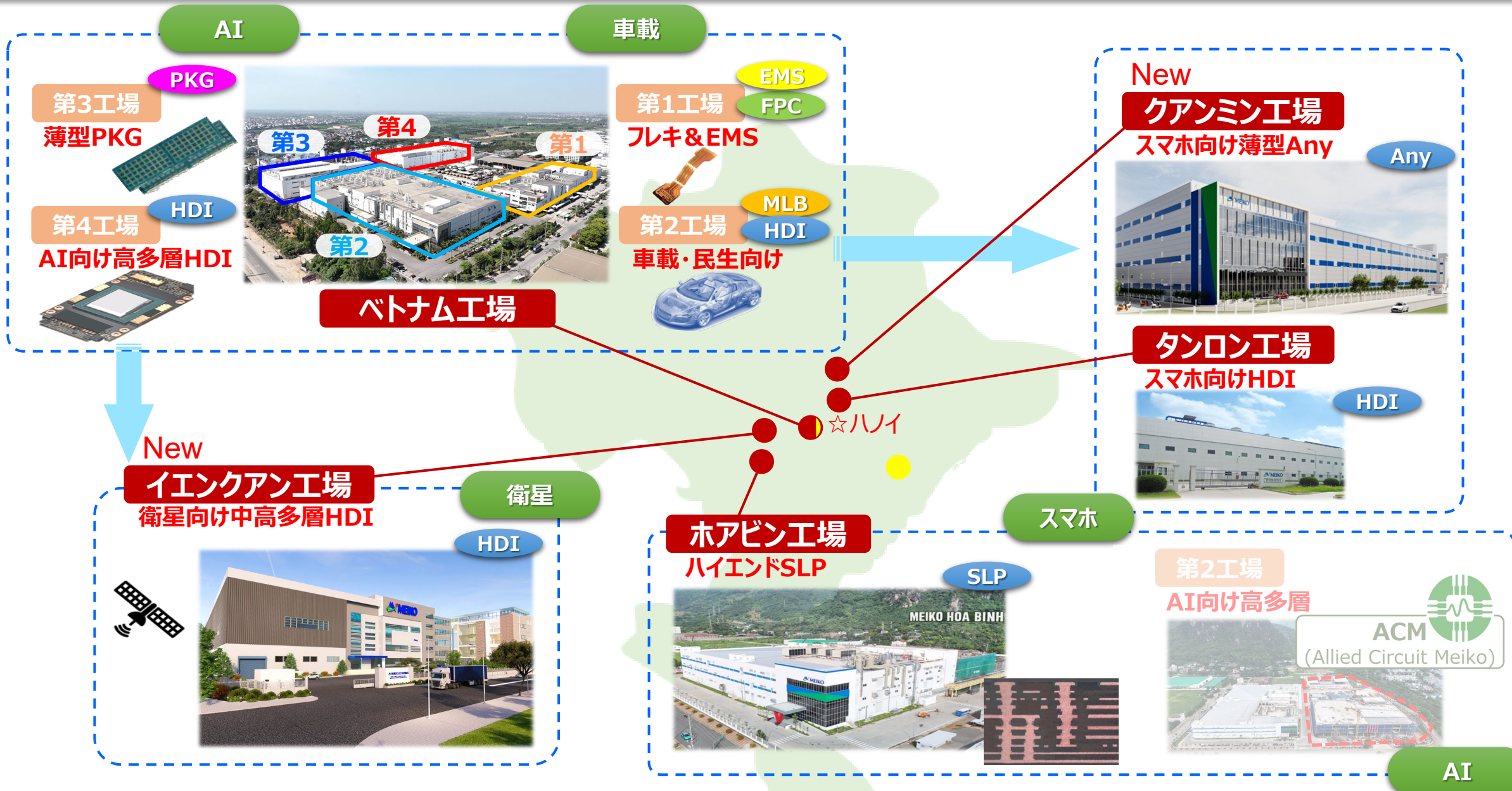
ベトナム第4工場

メモリーモジュール・アクセラレーターボード



高多層HDI基板

ベトナムPCB事業について



ベトナム第4工場の状況

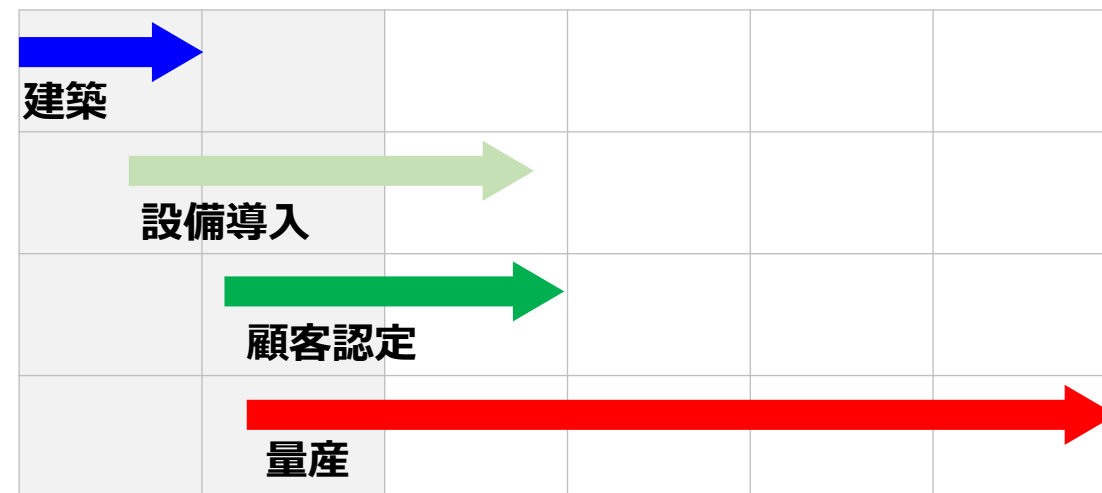
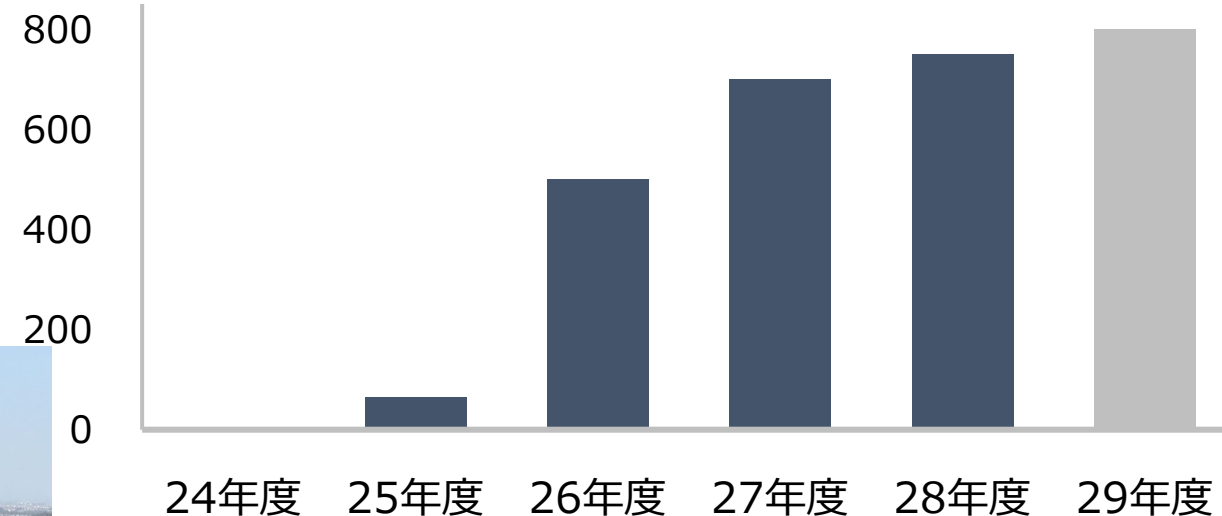
第2工場のキャパ不足により'25/7月から稼働中で現在もライン増設中。衛星・AIを中心とした量産開始。

ベトナム第4工場 事業概要

延床面積	約60,000㎡ (15,000㎡×4F)
投資規模	約250億円→約450億円
事業内容	第2工場(PCB)のキャパ補完 衛星・AI向け高多層ビルドアップ基板 メモリーモジュール基板

(億円)

【売上高計画】

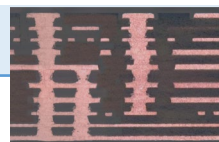


ホアビン工場の状況

今後のAI機器需要増を受け、電力の優位性などを踏まえ、ホアビンでの最先端工場の立ち上げを実施。

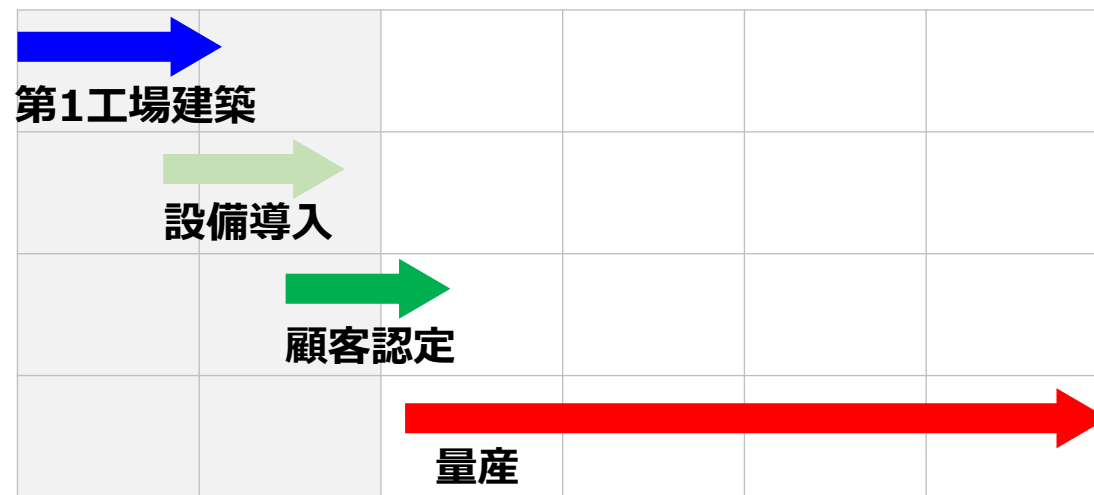
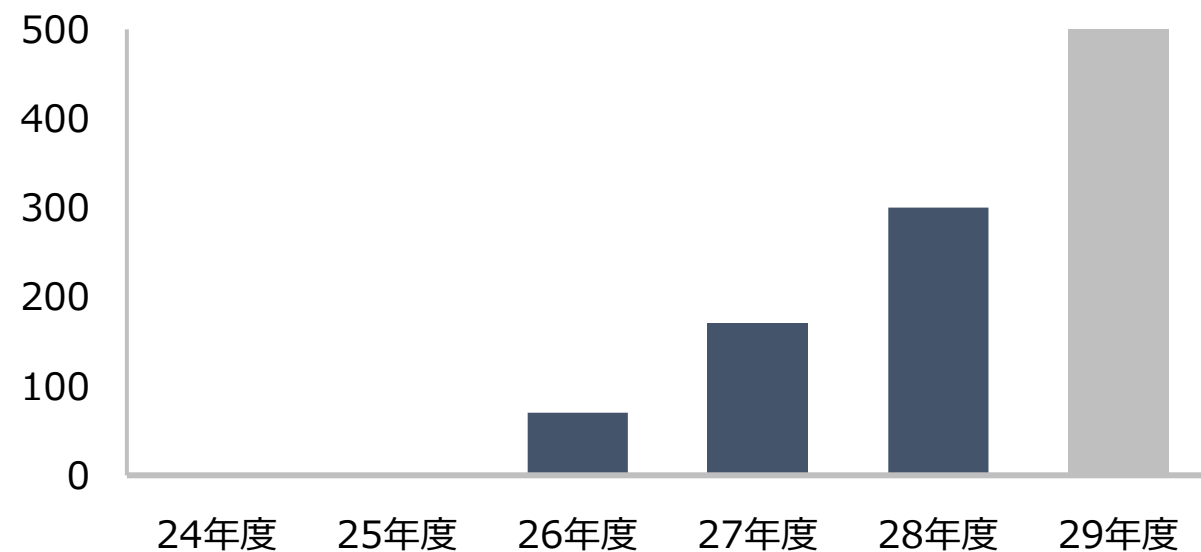
ホアビン工場 事業概要

所在地	ベトナム フート省 (旧ホアビン省)
敷地面積	約93,000m ²
延床面積	約60,000m ² (第1工場)
投資規模	約500億円 (第1工場)
事業内容	高周波・高密度ビルドアップ基板(SLP)



(億円)

【売上高計画】



ACCL社とのJ/V進捗状況

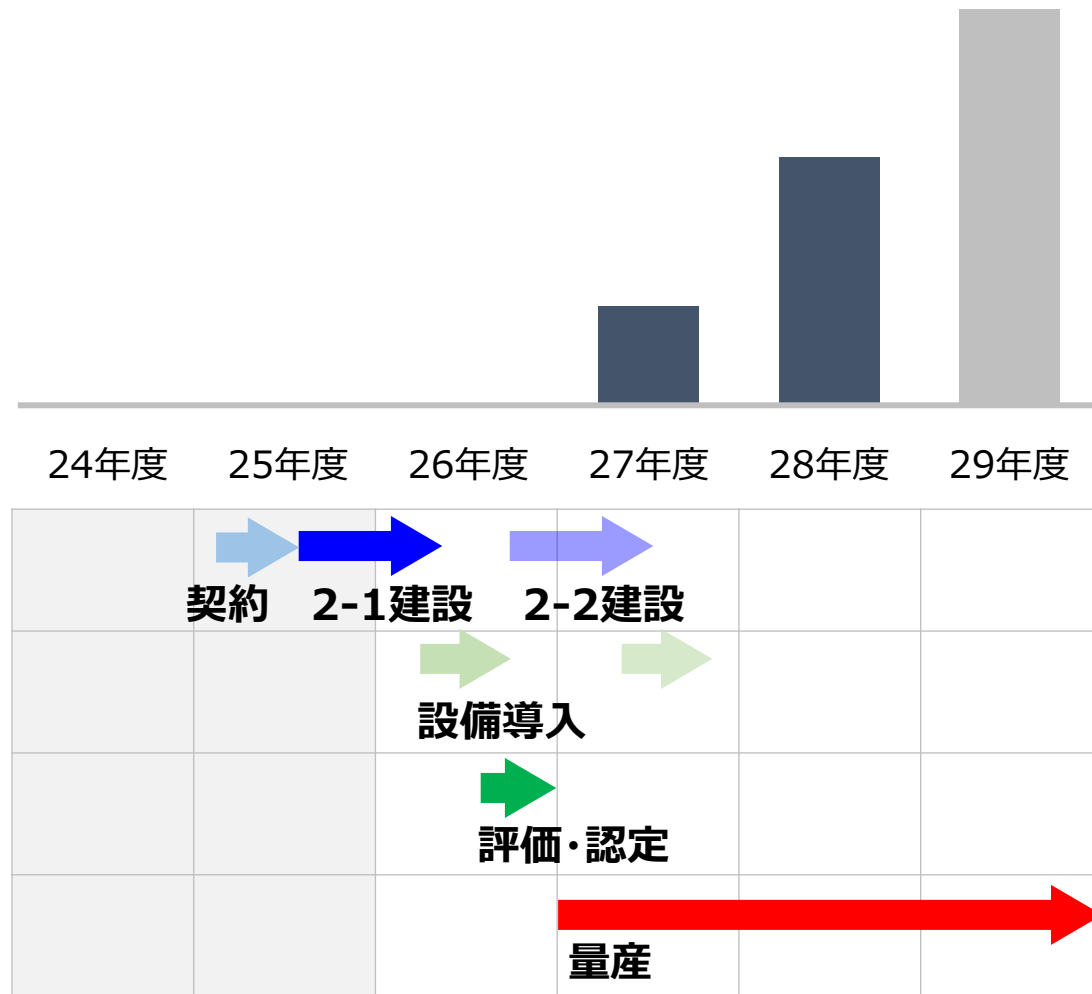
今後の東南アジアに於けるAIサーバーの需要増を見込み、ACCL社との提携で新規高多層事業に参入。

ACCL社とのJ/V会社概要



企業名	Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd.
出資比率	ACCL70%、Meiko30%
場所	ベトナム フート省（旧ホアビン省）
延床面積	約60,000㎡（第2工場）
事業内容	AIサーバー向け高多層基板

【J/V売上高計画】



ベトナム クアンミン第3工場の概要

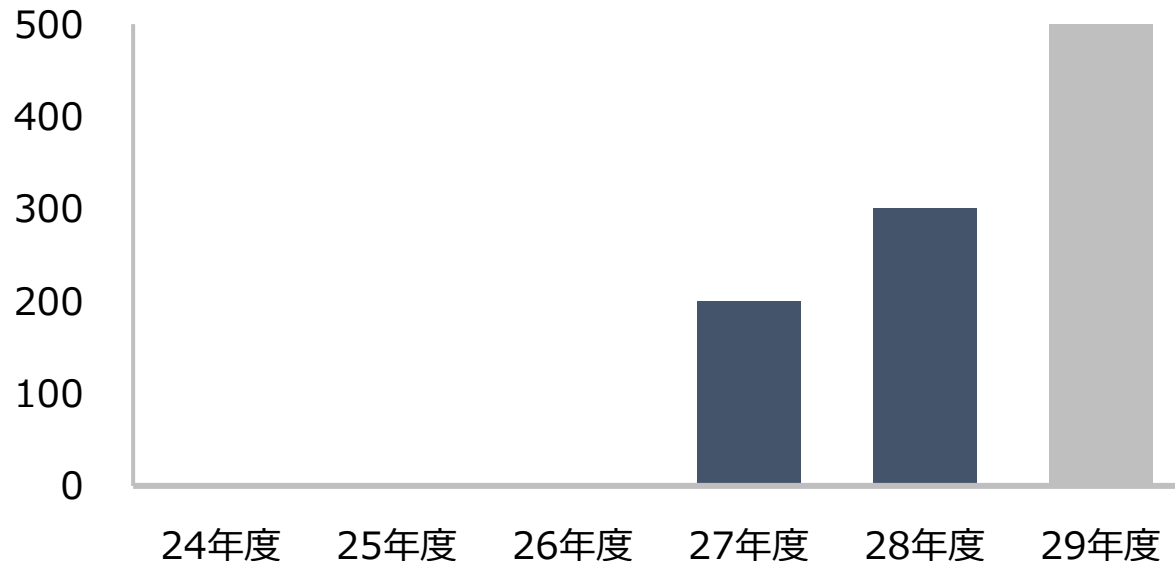
ベトナムPCB事業の需要増対応によるキャパ増設ならびに今後の薄型ハイエンドスマホ対応。

クアンミン第3工場 事業概要

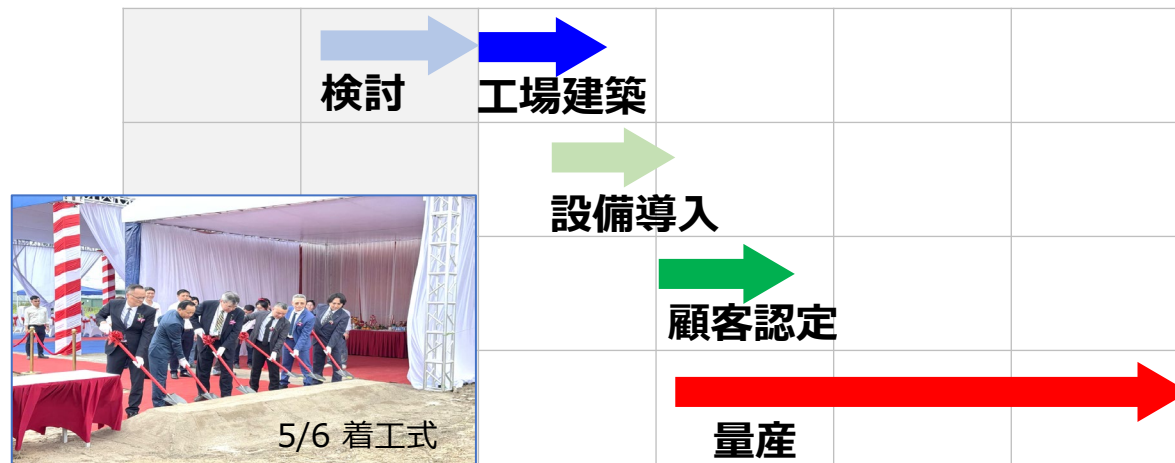
所在地	ベトナム ハノイ市 Quang Minh工業団地
敷地面積	約63,000㎡
延床面積	約53,000㎡ (第3工場)
投資規模	約400億円
事業内容	最先端高密度ビルドアップ基板

(億円)

【売上高計画】



(完成予想図)



ベトナム イエックアン工場の概要

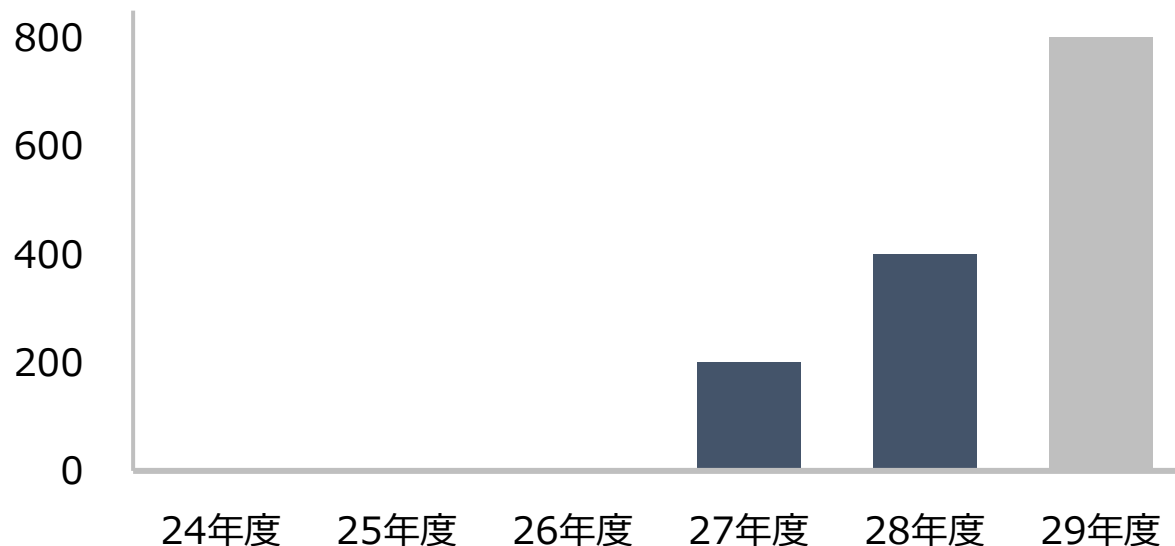
ベトナムPCB事業の分工場として、衛星案件を中心とした超高生産性中高多層ビルドアップ自動化工場を新設。

イエックアン工場 事業概要

所在地	ベトナム フート省 Amber Yen Quan工業団地
敷地面積	約110,000㎡
延床面積	約100,000㎡ (第1工場：20,000㎡×5F)
投資規模	約600億円
事業内容	衛星向け中高多層ビルドアップ基板

(億円)

【売上高計画】



(完成予想図)



電子機器事業のM&Aについて

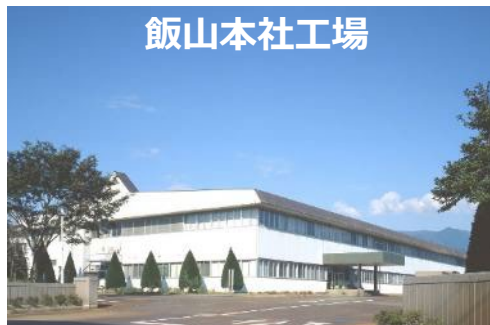
FCLコンポーネント株式会社

譲渡対象

事業内容	リレーカンパニー	複合事業カンパニー
本社	東京都品川区	長野県飯山市
従業員数	1,392名	573名

会社沿革

- 1967年 昭栄電子工業(株)設立
- 1983年 富士通へ譲渡し「(株)しなの富士通」に商号変更
- 1995年 「富士通高見澤コンポーネント(株)」設立
- 2001年 「富士通コンポーネント」設立、東証第2部上場
- 2009年 富士通メディアデバイスより無線モジュール事業譲渡
- 2018年 資本再編による上場廃止
- 2024年 商号を「FCLコンポーネント(株)」に変更



M & Aの狙い：受託設計開発ビジネスの強化

- 約150名のエンジニア獲得による開発力強化
- 無線通信・センサー等の先端ハード・ソフトウェア技術の取得
- 両社顧客基盤の融合によるクロスセル拡大と成長加速

主な商品	競争優位性
無線・センサーモジュール 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4～60GHz帯ミリ波までを網羅する無線技術 センサーでのエッジ側アルゴリズム・AI実装技術
車載電装機器 	<ul style="list-style-type: none"> CASE・SDV対応による電子電装機器の設計開発量産対応
精密加工部品 	<ul style="list-style-type: none"> 半導体装置装置、医療・車載等の厳しい仕様対応 コネクタなど微細・精密加工技術を保有
製造設備システム 	<ul style="list-style-type: none"> 金属加工、プレス、射出成型、金型、めっき、実装、組立含む製造設備設計から一貫量産対応
サーマルプリンタ 	<ul style="list-style-type: none"> 小型薄型設計、印字品質・速度等の優位性によりグローバルシェア第4位
タッチパネルモジュール 	<ul style="list-style-type: none"> タッチ性能、環境耐性を強みとし抵抗膜式パネルモジュールでグローバル市場シェアトップ
産業用特殊キーボード 	<ul style="list-style-type: none"> 医療・産業機器向けで操作性、防油、防塵、抗菌性等の耐久性に優位性
KVM 	<ul style="list-style-type: none"> 半導体製造装置向けKVMスイッチでの優位性 今後のAIデータセンター、ITインフラ対応